

导热灌封硅胶 RH-TCP-1158

特色:

- 双组分导热硅凝胶
- 低硬度，低模量，低应力，高回弹
- 加成体系，耐高温，无小分子释放
- 常温固化或加热加速固化
- 低挥发分，挥发性环体<300PPM
- 高热稳定性，耐热冲击循环

产品组成

- 硅凝胶
- 无机导热填料

产品应用

- 通用性导热灌封胶，灌封，如计算芯片，服务器等。
- 集成电路模块 PCB 导热
- 通用性逆变器、电池模组等封装灌封

常见性能参数*

产品名称	RH-TCP-1158
导热率（瞬态法）W(m·K)	1.5
硬度 Shore A	40-50
A 组分粘度， mPa.s	4000 ± 500
B 组分粘度， mPa.s	4500 ± 500
单/双组分	双（1：1） 灰/白
混合后密度 g/m	2.0 ± 0.1
击穿电压， KV/mm	≥20
体积电阻率 Ω·cm	≥1.0*10 ¹⁴
可操作时间 min, 25° C	30-60
初步固化时间 min, 25° C	80-120

应用方法

- 自动点胶机

固化条件

- 运输储存过程会有少量沉淀，在使用前需预先进行搅拌
- 初固：常温 1.5-2 小时
- 固化： 常温 24hr 或加热固化（e.g. 60 摄氏度 1hr， 100 摄氏度 0.5hr）

运输储存条件

双组分包装:

- 200L 铁桶包装
- 低于 45 摄氏度运输
- 常温保存，最佳使用期限为 3 个月以内

产品应用温度

通常有机硅材料在很大温度范围内保持稳定，考虑到综合性能和老化影响，此系列 -25 至 150 摄氏度范围内使用可获得最佳效果。如需其他温度范围，请咨询应用工程师。

其他注意事项

-
- 使用表面需保持清洁
- 工艺过程避免接触 N, S, P 等杂质
- 如需返工，再次使用前需清洁表面
- 点胶和涂胶过程中应避免气泡
- 避免人体皮肤直接接触